

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 10 月 13 日(13.10.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/126070 A1

(51) 国際特許分類:

C08L 63/00 (2006.01) *C08J 5/24* (2006.01)
B32B 5/28 (2006.01) *C08K 3/00* (2006.01)
B32B 15/08 (2006.01) *C08K 5/16* (2006.01)
B32B 27/38 (2006.01) *C08L 61/06* (2006.01)
C08G 59/62 (2006.01)

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2011/058791

(22) 国際出願日:

2011 年 4 月 7 日(07.04.2011)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願 2010-089801 2010 年 4 月 8 日(08.04.2010) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱瓦斯化学株式会社(MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.) [JP/JP]; 〒1008324 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小柏 尊明 (OGASHIWA Takaaki) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 高橋博史(TAKAHASHI Hiroshi) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 宮平 哲郎(MIYAHIRA Tetsuro) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 加藤 禎啓(KATO Yoshihiro) [JP/JP]; 〒1258601 東

京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 勝沼 宏仁, 外(KATSUNUMA Hirohito et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 富士ビル 3 2 3 号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
- 補正された請求の範囲 (条約第 19 条(1))

(54) Title: RESIN COMPOSITION, PREPREG AND LAMINATE

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、プリプレグおよび積層板

(57) Abstract: Disclosed is a resin composition for a printed wiring board, which has excellent heat resistance, excellent reflow resistance, excellent drillability and low water absorption, while maintaining excellent flame retardancy without using a halogen compound or a phosphorus compound. Specifically disclosed is a resin composition which contains (A) a non-halogen epoxy resin, (B) a biphenyl aralkyl phenolic resin, (C) a maleimide compound and (D) an inorganic filler.

(57) 要約: ハロゲン化合物やリン化合物を使用することなく、優れた難燃性を維持しつつ、耐熱性、耐リフロー性およびドリル加工性にも優れ、かつ吸水率も低いプリント配線板用樹脂組成物を提供する。本発明による樹脂組成物は、非ハロゲン系エポキシ樹脂 (A)、ビスフェニルアラールキル型フェノール樹脂 (B)、マレイミド化合物 (C)、および無機充填材 (D) を含む。



WO 2011/126070 A1